

LPKF erhält Großauftrag für Systeme zum Laserschneiden

Garbsen, 3. Juni 2010 – Zusätzlich zu dem starken Wachstum im Geschäft mit Systemen zur Laser-Direkt-Strukturierung (LDS) steht LPKF jetzt unmittelbar vor einem weiteren Marktdurchbruch. Das Unternehmen hat einen Großauftrag über Lasersysteme zum Trennen von Leiterplatten erhalten. Der Auftrag hat ein Volumen von knapp 6 Mio. Euro und wird im laufenden Geschäftsjahr im Segment Schneid- und Strukturierungslaser umsatzwirksam.

Das neu entwickelte LPKF MicroLine Lasersystem wird das Nutzentrennen in der Massenproduktion endgültig wettbewerbsfähig machen und die Genauigkeit des Schneidprozesses erheblich steigern.

Über weitere Einzelheiten des Auftrags wurde mit dem Kunden Stillschweigen vereinbart.

Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 0006450000).